



GH导热凝胶-GH High Thermal GELS

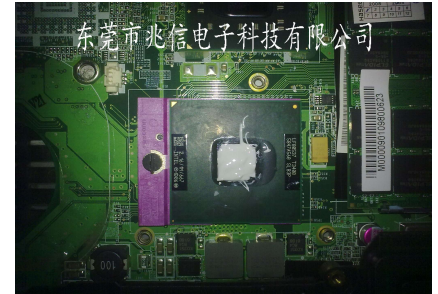
技术数据表 Technical Data Sheet



产品描述

CH系导热硅脂是呈膏状的高效导热产品，用于填充发热器件与散热器之间的间隙，充分润湿接触表面，形成超低热阻的热传导通道。

导热硅脂具有良好的导热性能，导热系数可以达到1.0-6.0 W/mK. 同时具有很好的流动性，可以在标准的点胶设备上点进行点胶操作，具有极高的操作便利性和效率。



Typical Applications :

- 芯片和散热器
- 电源和半导体
- 内存模块
- 微处理器/图形处理器
- 平板显示器和消费电子产品

Features/Benefits :

- 优异的电气绝缘性
- 良好的流动性，可以在标准点胶设备上点进行点胶操作
- 耐高低温、耐水
- 超低油分离
- 超低热阻
- 不硬化、无腐蚀

典型性能		导热硅脂	导热硅脂	导热硅脂	导热硅脂	导热硅脂	测试方法
		CH-10	CH-20	CH-35	CH-48	CH-60	
物理性能	颜色	白色	白色	兰色	灰色	灰色	目测
	密度 (g/cc)	2.4	2.52	2.6	2.7	2.9	ASTM D792
	压缩后典型厚度(mm)	0.05	0.05	0.09	0.1	0.1	ASTM D2240
热性能	导热系数(W/m.k)	1.0	2.0	3.5	4.8	6.0	ASTM D5470
	适用温度(°C)	-55~200	-55~200	-55~200	-55~200	-55~200	Zesion
	击穿电压(KV/mm)	>3	>3	>3	>3	>3	ASTM D149
	热阻率(°C-in ² /W@50PIS)	0.075	0.07	0.02	0.01	0.01	ASTM D257
常规性能	阻燃等级	V0	V0	V0	V0	V0	UL94
	RoHS	YES	YES	YES	YES	YES	SGS
	保质期(months)	18	18	18	18	18	Zesion

注：被涂覆产品表面擦拭干净至无杂质，用刷子，刮刀，玻璃棒或注射器涂布。

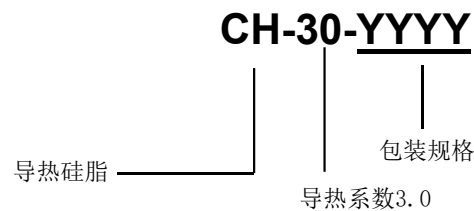
(continued on next page)

在使用过程中，会夹带少量空气，可通过静放，加压或真空排泡。。

包装信息

导热硅脂提供针管包装 50cc或300cc,或者桶装 1 kg , 5kg 和20 kg .

可以使用下面的料号进行物料信息识别



示例

CH30-0150 = 导热凝胶GH30 150g 支装

CH30-0900 = 导热凝胶GH30 900g 支装

CH30-2000 = 导热凝胶GH-30 2 kg 桶装

This information and our technical advise – whether verbal, in writing or by way of trials – are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale and Delivery.